

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2021 年 04 月)

证券简称: 华润微

证券代码: 688396

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☒ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 (请文字说明其他活动内容)
参与单位名称	国盛证券 民生证券 德邦证券 东兴证券 光大证券 广发证券 高盛证券 国金证券 华创证券 中金公司 开源证券 瑞信证券 天风证券 西部证券 长城证券 中泰证券 中信证券 安信证券 宝盈基金 贝莱德资管 博道基金 财通基金 大成基金 大和资本 大家资产 大岩资本 东方阿尔法基金

	东方基金
	东吴基金
	富敦投资
	富兰克林邓普顿
	工银瑞信基金
	光大保德信基金
	国都基金
	国融基金
	国新投资
	海富通基金
	恒盈资本
	红骅投资
	华安基金
	华富基金
	华美投资
	华泰柏瑞基金
	汇丰晋信基金
	嘉实基金
	建投资管
	建信基金
	景顺长城基金
	景泰利丰
	九泰基金
	聚鸣资管
	昆仑资管
	明河投资
	明亚基金
	摩根士丹利
	农银汇理
	诺安基金
	平安基金
	平安资产
	浦银安盛基金
	奇点资管
	趣时资产
	人保资产
	睿远基金
	润晖投资
	上海健顺投资
	上海聆泽投资
	上海荃笠资产
	上海泉汐投资
	尚峰投资
	深圳鑫然投资

	太平资产 途灵资产 万家基金 西部利得基金 香港宏利 信诚基金 星石投资 兴全基金 兴业基金 巽升资产 银河基金 银华基金 源乐晟资管 长盛基金 正心谷资本 中科沃土基金 中欧基金 中融基金 中银国际 朱雀基金
时间	04 月 30 日 10:00-11:00
地点	华润微电子总部会议室
上市公司接待人员姓名	李 虹 华润微电子执行董事、首席运营官 彭 庆 华润微电子董事、助理总裁兼财务总监 吴国屹 华润微电子董事会秘书兼战略总监
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：公司现阶段对今年下半年整体行业景气度的看法？ 当前市场景气上行，供需紧张的局面短期内无法得到有效的缓解。从公司在手订单和客户库存水位来看，公司对 2021 年全年保持乐观的态度。 问题二：公司今年一季度的毛利率较去年四季度，环比提高了 6 个百分点，主要有哪些原因？ 第一，去年四季度产品销售价格和代工价格提升在一季度有所显现； 第二，公司收购了东莞杰群 70%的股份并在去年四季度并表，目前东莞杰群和公司内部的协同效应开始逐步显现，有效地突破了公司一些功率产品的封装瓶颈，帮助公司进一步切入高端客户。

问题三：公司对 2021 年毛利率的后续展望？

目前市场需求旺盛，随着公司有序扩充产能、内部经营效率提升和客户结构改善，公司对今年整体毛利率提升保持谨慎乐观的态度。

问题四：目前市场产能紧张，是否存在重复下单的情况？

公司认为重复下单并不是普遍存在的情况，手机领域由于各大厂商竞争市场份额，可能存在一些重复下单的行为；但在其他领域的客户，无论是消费类、工控类还是汽车电子，库存水位都处在较低的水平，公司认为后续市场对于功率器件的需求依然会保持强劲的势头，产能紧张的问题在今年仍然会持续。

问题五：公司未来是否考虑采取进一步涨价的措施？

公司会采取随行就市的方式，针对客户结构、不同产品线及其终端应用等因素综合考虑价格策略。

问题六：目前市场供应紧张有无向上游传导的趋势？

目前国产八吋硅片的供应整体量还是比较充分的，国产八吋硅片价格相对稳定。国外硅片的供应商受疫情和产能紧张的影响，会出现供应紧张的局面，价格有一定调整。

问题七：公司如何平衡自有产品和代工客户的产能？

公司会保障原有代工客户的产能，但对于今年新增的晶圆制造产能，将更多地向自有产品倾斜。

问题八：公司在晶圆制造方面，今年有无新增产能？

公司无锡八吋线的募投项目已经开始建设，预计会在今年下半年释放一部分产能，主要和BCD、MEMS 产品有关；重庆八吋线升级改造项

	目也将会为今年新增一部分产能。 问题九：公司 12 吋产线何时可以贡献产能？目前规划的产能是多少？ 公司 12 吋产线预计在 2022 年可以实现产能贡献；目前该产线规划月产能为 3 万片，未来将主要用于自有功率器件产品的生产。 问题十：公司定增项目的规划，何时可以贡献产能？ 整个封测基地项目建设计划投入 42 亿，规划用于功率器件封装、先进封装以及面板级封装。 目前公司功率器件的封装大部分产能依靠外包，随着公司未来成品化率提高和 12 吋产线投产，公司希望提高封测业务的产能，通过封测配套来提高产品业务附加值。封测基地项目中，功率器件的封装为自身产品做配套，一部分先进封装会进行对外代工，如面板级封装，技术具备差异性和领先性。 整个封测项目规划三年时间，公司希望明年功率器件的封装产线开始量产用于自有产品。 问题十一：公司如何看待未来几年功率产品的成长空间？ 一、MOSFET 方面：目前国内约 90% 的高端产品市场份额仍被国外厂商占据，公司正在积极布局中高端领域，未来国产替代空间大。 二、IGBT 方面：在该领域公司未来主要的增量来自于产品应用领域的突破以及 IGBT 模块产品的上量，公司模块产品已在工业电源方面完成客户验证，已经开始销售。 三、第三代化合物半导体方面：公司拥有国内领先的 SiC 生产线，SiC 二极管产品已经突破销售，预计今年将进一步推出 SiC MOSFET 产品。此外，公司积极布局 SiC 上下游产业链，参股了一些 SiC 材料端的公司，更好地保障 SiC 产品供应链。GaN 产品 6 吋和 8 吋平台同步开展研发。 问题十二：公司内部对人才有哪些激励机制？
--	--

	公司对于研发人员采取了多种激励措施：实施市场化的薪酬体系；建立项目跟投、研发项目激励等制度；公司已于 2020 年 12 月将采用第二类限制性股票的股权激励方案提报国资委进行审批。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 04 月